

DAWON NEXVIEW

Micro 기술로 Macro 세상을 변화시키는 다원넥스뷰



World Wide Business

| World Best Product

| World First Process

DISCLAIMER

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시하는 IR Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 다원넥스뷰(이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영환경 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’, ‘F’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 시장상황에 따라 대내외적인 불확실성을 내포하고 있는 바, 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영목표 등을 고려한 것으로 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지없이 변경될 수 있음을 양지바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대해서 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정, 투자 결정을 위한 기초자료가 될 수 없습니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고 (단, 출처표기 필수), 회사의 사전 승인없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.



스마트폰으로 QR 코드를 인식하시면,
홈페이지, 기업설명회 영상 확인 및 IR 자료를
다운로드 하실 수 있습니다.

Summary

- 회사 개요

- 신성장 동력

- 회사 연혁

- 시장 전망

Company & Business

- 주요 사업 영역

- 핵심 기술 소개

DAWON
NEXVIEW

GLOBAL TOP
LASER MICRO-PROCESS
SOLUTION PROVIDER

초정밀 마이크로 레이저 접합 장비 전문기업 다원넥스뷰



대표이사 남 기 중

- 연세대학교 물리학과 학사, 석사, 박사
- University of Emory / Post Doc
- 고등기술연구원 / 레이저 응용 기술 센터장
- ㈜제이스텍 CTO / 사업본부장 겸
- ㈜다원넥스뷰 대표이사 (2010.07~ 현재)
- 2019년 벤처창업진흥유공 표창장
- 2021년 무역의날 수출의탑 수상
- 2022년 장영실상 수상
- 2023년 세계일류상품 인증서 수상
- 2023년 대한민국 우수특허 대상

회사 개요

기업명	주식회사 다원넥스뷰
대표이사	남기중
설립일	2009년 11월 20일
자본금	76억원
사업분야	레이저 응용 장비 개발 제조(마이크로 접합/가공)
임직원수	67명 (2024.08 기준)
본사 소재지	경기도 안산시 단원구 시화호수로 485
홈페이지	www.nexview.co.kr

인증 및 수상 현황



기술성평가

AA · BBB

지식재산권
(22건 등록, 11건 출원)

33

국책과제

12

선도적인 연구와 개발로 혁신의 역사 지속

2009~2013

설립기

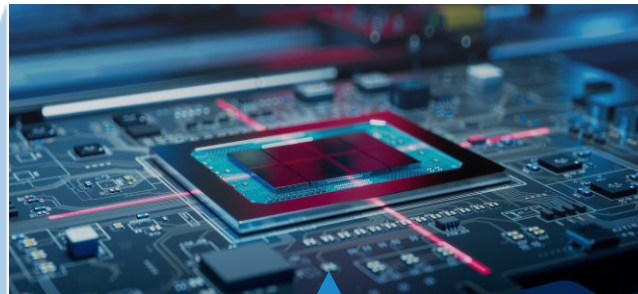


LSMB 핵심 기술 형성기
스마트폰, 자동차 전장 시장 중심

- 2013 Laser Micro-Soldering 장비 납품 (스마트폰 스피커/리시버 양산)
- 2011 기업 부속 연구소 설립
- 2010 Laser Micro-Soldering 기술 개발 (스마트폰, 자동차 전장 시장 진입 기술)
- 2009 법인 설립

2014~2018

구축기

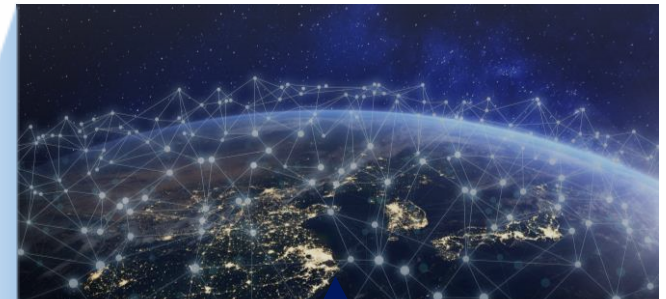


pLSMB 기술 개발 / 제품 출시
(반도체 테스트 공정 시장 본격 진입)
sLSMB 기술 개발

- 2018 Laser Micro-Solder Ball Jetting 기술 개발 (반도체 패키징 공정 시장 진입 기술, sLSMB)
- 2017 Laser Micro-Bonding 장비 납품 (국내 및 세계 1위 프로브카드사 Formfactor)
- 2016 Laser Micro-Soldering 장비 납품 (현기차 초음파센서 양산)
- 2015 Laser Micro-Soldering 장비 납품 (현기차 주차보조센서 인라인 양산)
- 2014 Laser Micro-Bonding 기술 개발 (반도체 테스트 공정 시장 진입 기술, pLSMB)

2019~

성장기



pLSMB 제품 판매처 확대 및 수출 본격화
sLSMB 제품 출시
(반도체 패키징 공정 시장 본격 진입)

- 2024 코스닥 상장
- 2023 세계일류제품 인증서 수상 (산업통상자원부/KOTRA) 대한민국 우수특허 대상 수상 (건설/기계 부문)
- 2022 장영실상 수상 (Laser Micro-Bonding System) 차세대 Laser Micro-Bonding 장비 납품 (국내 최초 DRAM용 High Speed Bonder)
- 2021 백만불 수출의탑 수상 Laser Micro-Bump Mounter 장비 납품 (세계 최초 FC-BGA 반도체 기판 양산 라인 적용)
- 2020 Laser Micro-Bonding System Turn-Key 납품 (중국 메모리용 프로브카드 시장 본격 진출)
- 2019 코넥스 상장 (A323350) 벤처활성화 유공 표창 (중소벤처기업부) Probe Card Assembly Process Full 자동화 완성 (Probe Cutting, Inserting, Inspection, Repair)

반도체 테스트/패키징 공정에 적용되는 레이저 마이크로 접합 공정 솔루션 보유

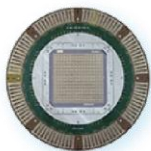
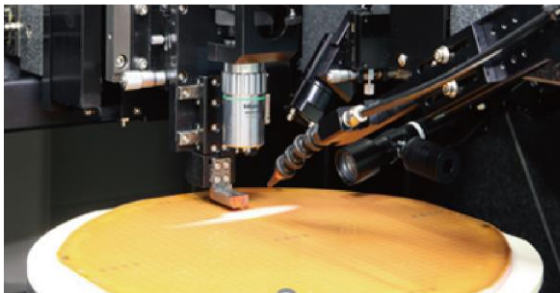
LSMB

* LSMB: Laser Systemic Micro-Bonding

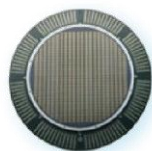
pLSMB

반도체 테스트 부문

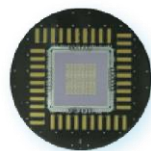
메모리 및 비메모리 웨이퍼 테스트용
고속/고정밀 프로브카드 탐침 접합 장비



DRAM



NAND FLASH

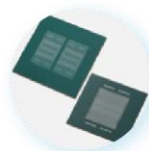
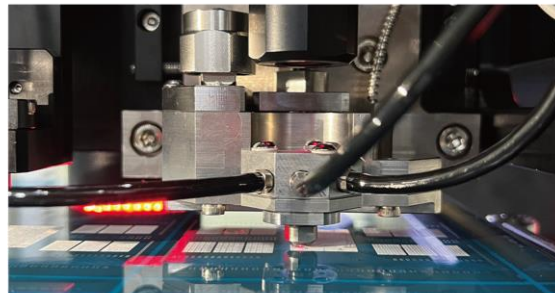


CIS

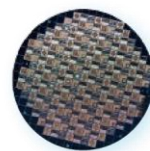
sLSMB

반도체 패키징 부문

패키징 기술 고도화(Chiplet화/대면적화)에 대응하는
첨단 마이크로 솔더볼 범핑 공정 장비



Flip Chip
Substrate



FI, FO-WLP

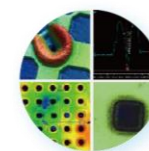
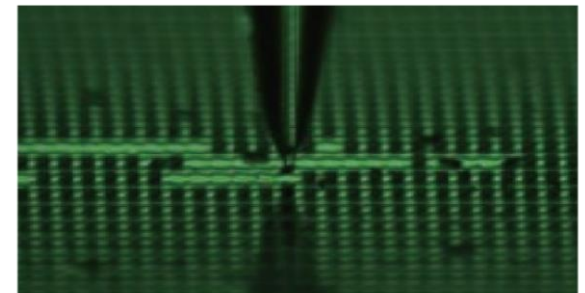


BGA/Camera
Module

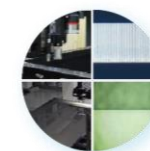
dLSMB

차세대 디스플레이 부문

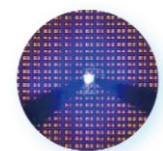
차세대 디스플레이용
마이크로 LED 리페어 솔루션



FMM Repair



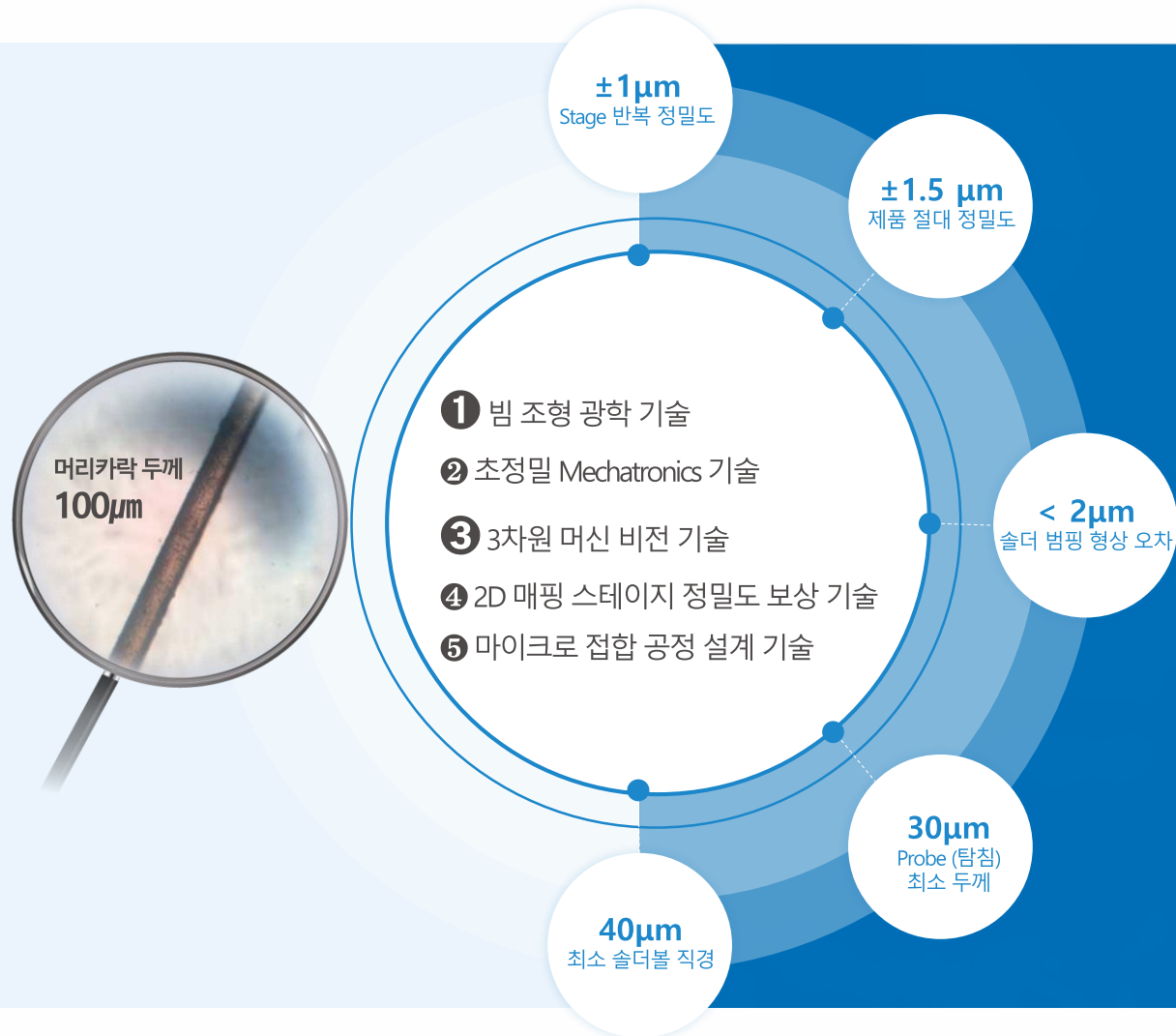
UTG Cutting



Micro LED
Repair

세계 최고 수준의 초정밀 레이저 마이크로 본딩 기술

'LSMB'; Laser Systemic Micro-Bonding Technology



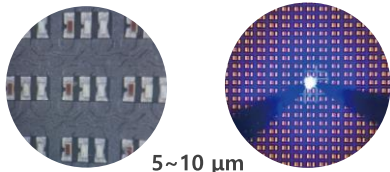
“Micro 기술로 Macro 세상을
변화시키는 다윈넥스뷰”

기존 반도체는 물론 첨단 디스플레이 시장을 중심으로 사업 확대

01 dLSMB

- 리페어 공정의 공대 불량, 레이저로 미세 홀 재형성
- FMM 국산화 및 uLED Assembly 공정 수율 증가

마이크로 LED 리페어



FMM 리페어



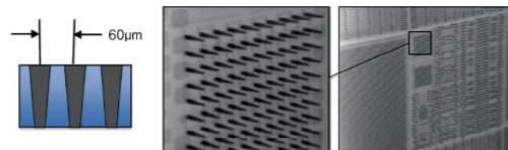
02 UTG Cutting System & 2.5D Packaging

- 폴더블 및 플렉서블 디스플레이용 UTG 형상 가공 장비 개발 진행
- 차세대 반도체인 글라스 인터포저 장비 개발 진행

Full Auto UTG Cutting



Glass Substrate Interposer Cutting/Drilling

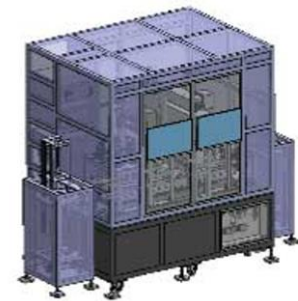


자료: Metalized TGV X-ray Images (Dai Nippon Printing)

03 Laser Scribing System

- 실리콘을 대체할 차세대 소재인 페로브스카이트 솔라셀 장비까지 제품군 확대

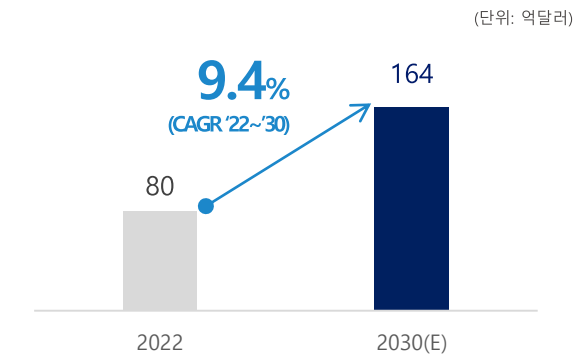
Solar Cell Laser Scribing



고성능-저전력 AI 반도체 수요 확대로 고도화된 첨단 반도체 기술 요구

전방시장 현황 및 전망

글로벌 FC-BGA 시장 규모



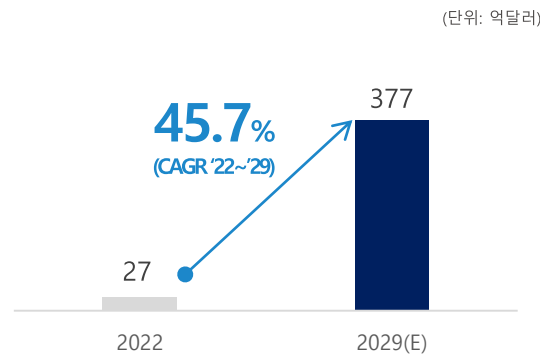
자료: 후지카메라연구소

AI 및 고성능 반도체 기반
수요 증가로 FC-BGA 시장 확대

sLSMB

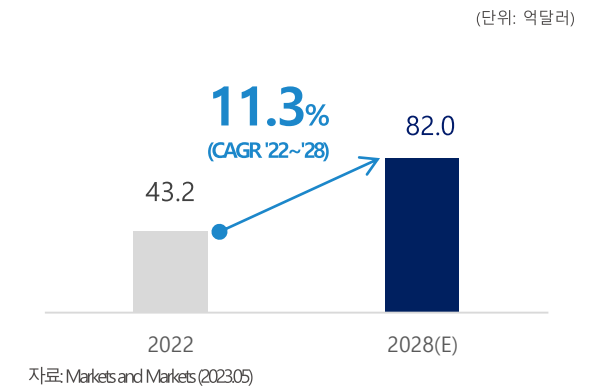
세계 최초 솔더볼 젯팅 기술 기반
솔더 범프 마운팅 설비 생산

글로벌 HBM 시장 규모



- AI 서버 및 데이터센터 급증으로 미국 주요 기업 시칩 확보와 공급망 다각화
- 해외 의존도 높은 HBM 공급망 안정화 이슈로 국내 소부장 육성 강화
- HBM의 급부상으로 반도체 후공정 기술력 제고를 위한 노력 강화 시급

글로벌 2.5D & 3D 패키징 시장 규모



HBM 수요 폭증으로
프로브카드 탐침 장비의 수요 증가

pLSMB

일일 1만개의 탐침을 접합하는
세계 최고 수준의 프로브 본딩 장비 개발

Fact Sheet

2024년 1H

- 4개년도 매출 추이

- 실적 요약

- 요약 재무제표

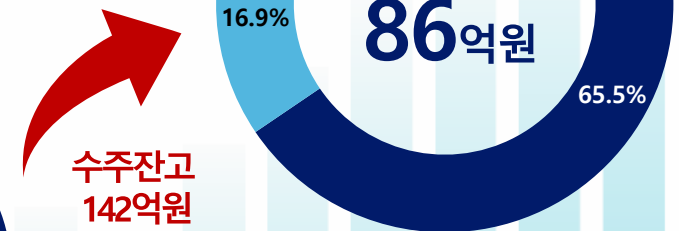
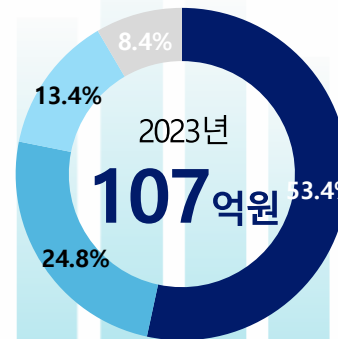
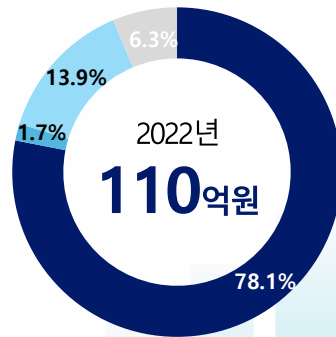
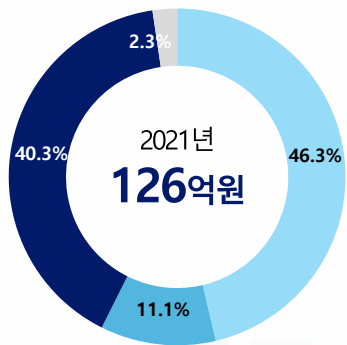
DAWON
NEXVIEW

GLOBAL TOP
LASER MICRO-PROCESS
SOLUTION PROVIDER

지난해 142억원의 역대급 수주잔고 기록, 지속성장 기반 마련

부문별 매출 비중

■ pLSMB ■ sLSMB ■ dLSMB 외 ■ 기타



수주잔고
142억원

신규 수주 확대에 따라 매 분기별 매출 경신

분기별 손익 요약

(단위: 백만원)

구분	2023.1H	2024.1Q	2024.2Q	2024.1H	YoY
매출액	4,478	3,535	5,025	8,560	91.1%
매출원가	3,912	2,666	3,962	6,628	-
매출총이익	566	869	1,063	1,932	241.1%
(%)	12.6%	24.6%	21.2%	22.6%	10.0P
판매비와관리비	1,104	432	1,267	1,698	-
영업이익(손실)	(538)	437	(204)	234	143.5%
(%)	△12.0%	12.4%	△4.1%	2.7%	14.7%P
법인세비용차감전순이익	4,060	430	(5,779)	(5,349)	△231.7%
법인세비용(수익)	(261)	-	67	67	-
당기순이익(손실)	4,321	430	(5,712)	(5,282)	△222.2%
(%)	96.5%	12.2%	△113.7%	△61.7%	△158.2P

*자료: 다원넥스뷰 반기보고서

상반기 매출액 YoY 91.1% ↑, 포트폴리오 다각화로 점진적 매출 비중 증가

 부문별 매출 요약

(단위: 백만원, K-USD)

품목	2023.1H	(%)	2024.1Q	(%)	2024.2Q	(%)	2024.1H	(%)	YoY
pLSMB	2,185	48.8%	1,190	33.7%	4,418	87.9%	5,608	65.5%	156.7%
sLSMB	1,221	27.3%	1,450	41.0%	-	-	1,450	16.9%	18.8%
dLSMB	732	16.4%	355	10.1%	369	7.4%	725	8.5%	△1.0%
기타	341	7.6%	539	15.3%	238	4.7%	777	9.1%	128.1%
Total	4,478	100.0%	3,535	100.0%	5,025	100.0%	8,560	100.0%	91.1%
수출	3,475	77.6%	1,827	51.7%	2,160	43.0%	3,986	46.6%	14.7%

*자료: 다원넥스뷰 제공

03. 요약 재무제표

요약 재무상태표

(단위: 백만원)

과 목	FY21	FY22	FY23	FY24.1H
유동자산	4,350	5,931	11,866	18,425
비유동자산	5,311	4,651	5,024	5,217
자산총계	9,660	10,582	16,890	23,641
유동부채	10,558	24,404	12,219	8,449
비유동부채	731	692	887	2,202
부채총계	11,289	25,096	13,106	10,651
자본금	459	459	631	760
기타불입자본	2,965	4,145	22,156	36,516
이익잉여금	(5,052)	(19,118)	(19,004)	(24,286)
자본총계	(1,629)	(14,514)	3,783	12,990

*K-IFRS 기준

요약 손익계산서

(단위: 백만원)

과 목	FY21	FY22	FY23	FY24.1H
매출액	12,557	10,991	10,654	8,560
매출원가	9,829	7,750	8,658	6,628
매출총이익	2,728	3,241	1,996	1,932
판매비와관리비	2,329	2,468	2,637	1,698
영업이익	399	773	(641)	234
영업외수익	1,878	9,923	1,210	103
영업외비용	339	928	423	5,685
법인세비용차감 전순손익	1,938	9,768	146	(5,349)
법인세비용	(68)	(158)	57	67
당기순이익	2,006	9,926	89	(5,282)

*K-IFRS 기준